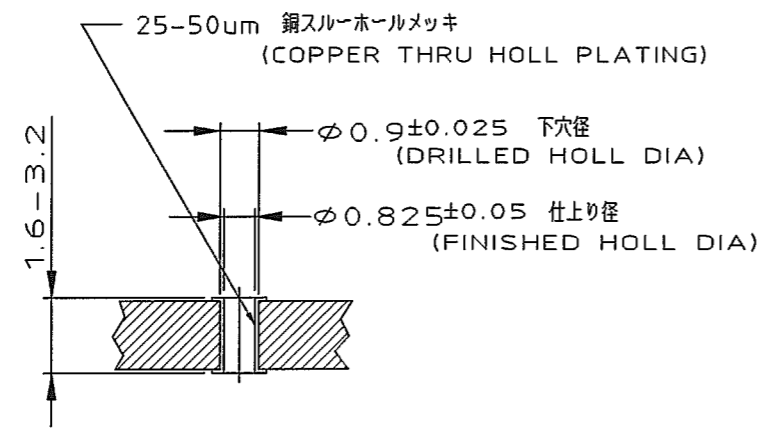
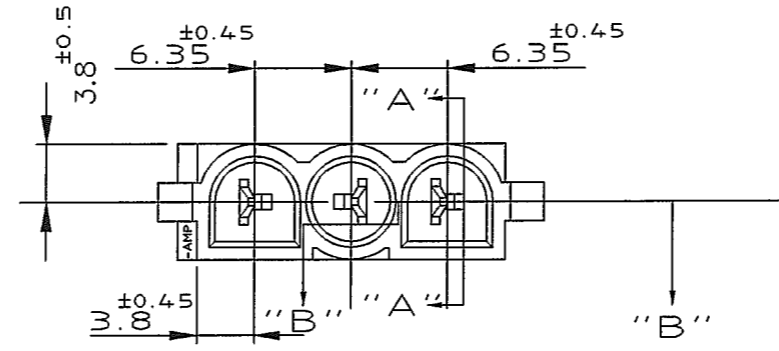


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 01DEC,01NOV1993  
 © COPYRIGHT 1993 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
J	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		G1	REVISED	ECR-05-000591	9MAR2005	J.A	D.M

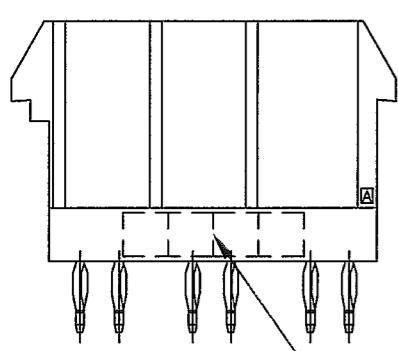


推奨基板スルーホール径  
 (RECOMMENDED THRU-HOLE DIA OF P.C.BOARD)

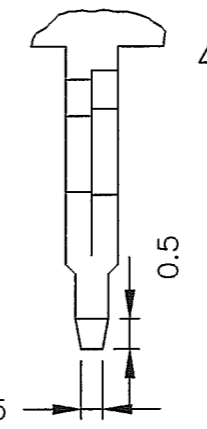
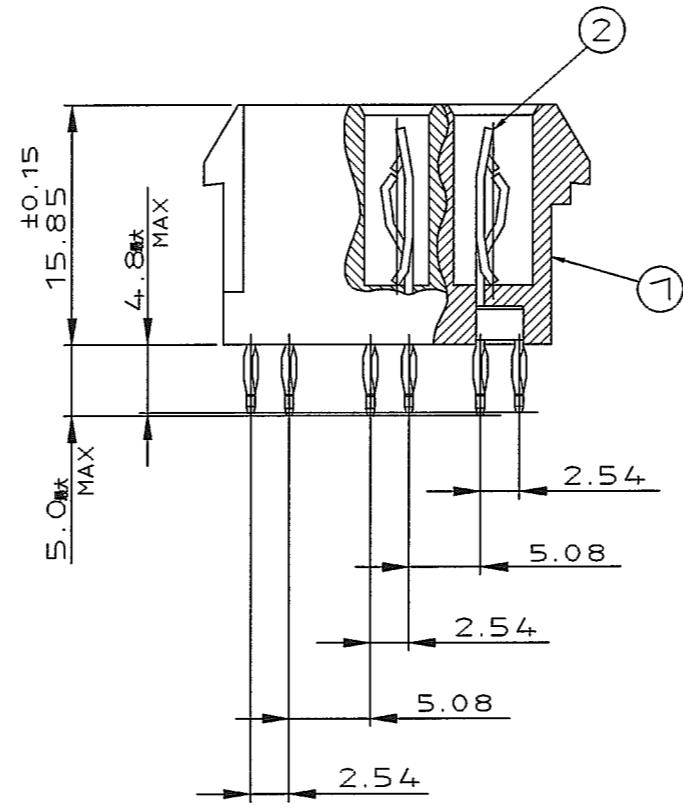
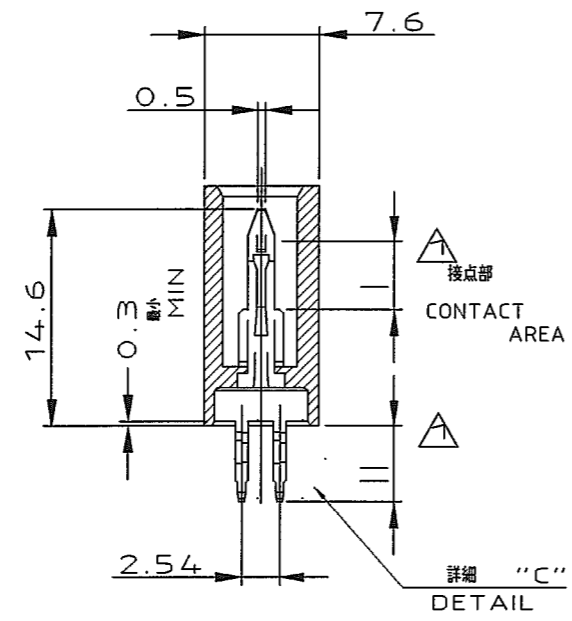


△ FINISH : CONTACT AREA ; TIN PLATING(MATTE) 2.0μmMIN OVER ALL Ni PLATING.  
 ACTION AREA ; TIN PLATING(MATTE) 0.5-2.54μm OVER ALL Ni PLATING.  
 ANOTHER ; TIN PLATING(MATTE) NOT CONTROL THK.

- MATCHING SOCKET IS TO BE USE P/N:350550-3,350551-3,350689-3,350919-3,640310-3
- CURRENT : 15A/PIN MAX.  
 WHEN USE AWG#14 UL-1015 ×CENTER WIRE N=4/0.28mm  
 ×INSULATION DIA 3.8mm
- PRODUCT SPECIFICATION : 108-5222

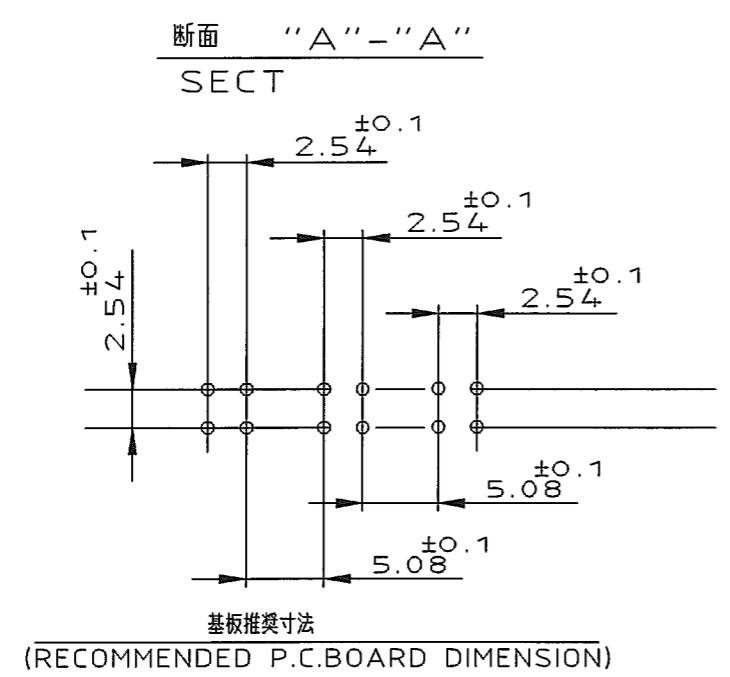


DATE CODE



△ メッキ仕様:  
 コンタクト部: ニッケル下地メッキの上に 2.0μmMIN のスズめっき(半光沢)を施す。  
 アクション部: ニッケル下地メッキの上に 0.5-2.54μm のスズめっき(半光沢)を施す。  
 それ以外は特に規定しないスズめっき(半光沢)を施す。

- 相手側ソケットは P/N:350550-3,350551-3,350689-3,350919-3,640310-3 を使用のこと。
- 規格電流: 15A 最大 (個当たり)  
 但し、使用電線 AWG#14 UL-1015  
 芯線: 4本/0.26mm  
 被覆外形: phi 3.8mm
- 製品規格: 108-5222



基板推奨寸法  
 (RECOMMENDED P.C.BOARD DIMENSION)

断面 "B"- "B"  
 SECT

銅合金 COPPER ALLOY	ガラス入り熱可塑性樹脂、黒色 GLASS FILLED THERMO-PLASTIC, BLACK	△	173925-1
2 コンタクト CONTACT	① ハウジング HOUSING	表面処理 FINISH	型番 PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K.NEMOTO 30NOV1993	tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki,Japan	
DIMENSIONS: 単位: 特 MM	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	CHK T.SASAKI 01DEC1993	NAME 名称 3POS, ACTION PIN U-M-N-L PIN HEADER ASSEMBLY	
MATERIAL 材料 SEE TABLE	FINISH 仕上 △	APVD Y.TANIKAWA 01DEC1993	SIZE A3	
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5222	CAGE CODE 00779	
		APPLICATION SPEC 取付適用規格	DRAWING NO 番号 C-173925	
		WEIGHT 2.85 g	RESTRICTED TO —	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 1:1
				SHEET 1 OF 1
				REV G1